

希荻微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他：电话会议 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>参与人员名单：</p> <p> 【中邮创业基金管理股份有限公司】:陈子龙 【兴合基金管理有限公司】:侯吉冉 【太平基金管理有限公司】:王达婷 【东兴基金管理有限公司】:张胡学 【国融基金管理有限公司】:陈晓晨 【AROHI 资产管理有限公司】:朱昱霖 【深圳市惠通基金管理有限公司】:王青晨 【上海森锦投资管理有限公司】:高峰 【毕盛(上海)投资管理有限公司】:蔡景彦 【永安国富资产管理有限公司】:王成梁 【北京才誉资产管理企业(有限合伙)】:唐毅 【新活力资本投资有限公司】:陈晓静 【深圳市领骥资本管理有限公司】:方力 【上海景领投资管理有限公司】:王胜 </p>

【北京橡果资产管理有限公司】:魏鑫
【上海敦颐资产管理有限公司】:刘涛
【苏州君榕资产管理有限公司】:陈宇
【耕霖（上海）投资管理有限公司】:陈洋洋
【丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司】:孙啸
【厦门君宸达资本管理有限公司】:陈友强
【深圳市投控资本有限公司】:赵颖楠
【上海明河投资管理有限公司】:姜宇帆
【深圳市投控资本有限公司】:张晟
【西藏源乘投资管理有限公司】:刘小璜
【杭州汇升投资管理有限公司】:刘炜
【深圳前海旭鑫资产管理有限公司】:李凌飞
【博裕资本有限公司】:余高
【广东润达私募基金管理有限公司】:赵维卿
【明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司】:朱腾飞
【深圳丞毅投资有限公司】:胡亚男
【青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)】:李润泽
【广州睿融私募基金管理有限公司】:许高飞
【鸿运私募基金管理（海南）有限公司】:舒殷
【国联证券股份有限公司】:熊军
【信达证券股份有限公司】:王义夫
【国信证券股份有限公司】:胡慧
【上海证券有限责任公司】:李想
【华鑫证券有限责任公司】:高永豪
【中国国际金融股份有限公司】:杨晓宇
【朱雀基金管理有限公司】:赵晗泥
【华安证券股份有限公司】:李元晨
【西南证券股份有限公司】:李明明

【西部证券股份有限公司】:王勇
【中原证券股份有限公司】:邹臣
【中航证券有限责任公司】:刘牧野
【招商证券股份有限公司】:谌薇
【华泰证券股份有限公司】:丁宁
【东方证券股份有限公司】:薛宏伟
【德邦证券股份有限公司】:谢文嘉
【汇丰前海证券有限责任公司】:苏增慧
【开源证券股份有限公司】:罗通
【海通证券股份有限公司】:肖隽翀
【上海申银万国证券研究所有限公司】:杨海晏
【太平洋证券股份有限公司】:罗平
【兴业证券股份有限公司】:刘珂瑞
【华福证券有限责任公司】:魏征宇
【摩根大通证券(中国)有限公司】:许日
【华西证券股份有限公司】:卜灿华
【民生证券股份有限公司】:童秋涛
【华金证券股份有限公司】:王海维
【财通证券股份有限公司】:王矗
【摩根大通证券（中国）有限公司】:刘叶
【中泰证券股份有限公司】:王九鸿
【上海东方证券资产管理有限公司】:廖家瑞
【国金证券股份有限公司】:邓志维
【中汇人寿保险股份有限公司】:曹勇
【中国银河证券股份有限公司】:翁林开
【东亚前海证券有限责任公司】:宗佳颖
【安信证券股份有限公司】:杨中国
【平安证券股份有限公司】:刘明
【深圳市领投科技有限公司】:安江波

	<p>【Point72HongKongLimited】:郑天涛</p> <p>【东兴证券股份有限公司】:刘航</p> <p>【亚太财产保险有限公司】:赵润颐</p> <p>【国新风险投资管理（深圳）有限公司】:郭嘉浩</p> <p>【民生证券股份有限公司】:童秋涛</p> <p>【立格资本投资有限公司】:李学来</p> <p>【德邦证券股份有限公司】:陈瑜熙</p> <p>【上海吾同投资管理有限公司】:王林</p> <p>【《中国基金报》社有限公司】:吴海飞</p> <p>【山东海科新源材料科技股份有限公司】:张金峰</p> <p>【金股证券投资咨询广东有限公司】:曹志平</p> <p>【上海优越商务咨询有限公司】:李海涛</p> <p>【广西赢舟管理咨询服务服务有限公司】:程悦</p> <p>【深圳市德俊咨询有限公司】:周泽翊</p> <p>【纳弗斯信息科技（上海）有限公司】:李怀斌</p> <p>【太平资产管理有限公司】:马姣</p> <p>【华安财保资产管理有限责任公司】:李亚鑫</p> <p>【大家资产管理有限责任公司】:徐博</p> <p>【北京富智投资管理有限公司】:李晓迪</p> <p>【新余中道投资管理有限公司】:吴宏伟</p>
时间	2024年5月7日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>【主讲人】:</p> <p>TAO HAI（陶海） 董事长、总经理</p> <p>唐娅 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分介绍公司的整体情况</p> <p>第二部分问答环节</p> <p>Q: 请问公司音圈马达驱动芯片业务增长比较快的主要原因是什么? 能否拆解一下 2023 年或者 2024 年第一季</p>

度音圈马达驱动芯片的出货结构？

A：公司音圈马达驱动芯片业务增长较快的原因主要包括两方面：首先，公司的自动对焦和光学防抖芯片已成为市场出货的主流选择，市场占有率较高；除此之外，公司部分终端客户的新品发布推动了公司业务快速增长。2023年和2024年第一季度，公司音圈马达驱动芯片业务的出货结构包括开环式和闭环式自动对焦芯片以及光学防抖芯片，其中光学防抖芯片的产品单价最高，其单机用量与手机摄像头的数量成正比的，摄像头的数量越多，单机需要用到的芯片颗数就越多。

Q：请问公司电源管理芯片销量下降的原因是什么？公司电荷泵芯片产品的主流出货类型是哪种？

A：2023年，公司电源管理芯片产品线的销量下降，主要是由于手机市场对DC/DC芯片的需求量有所减弱。公司电荷泵芯片产品目前主要出货的是2:1架构。

Q：请问公司如何看待电源管理芯片本年度销售情况？

A：2024年，公司2:1架构的电荷泵芯片产品对应的市场份额有望进一步上涨，且公司针对硅阳极锂电池新推出的DC/DC芯片产品有望给公司业务带来增量。

Q：请问公司新推出的股权激励的业绩考核目标是偏保守的吗？是按照怎样的口径来计算？

A：2024年，公司采取了相对稳健的股权激励策略，以财务报表中的营业收入为基准，作为公司层面的主要业绩考核目标。公司对未来三年业务持续健康发展怀有信心。

	<p>Q: 请问手机市场的景气度如何?</p> <p>A: 总体来看, 相比 2023 年, 手机市场在 2024 年有望迎来温和复苏, 但具体到不同的终端客户, 可能会存在不同的情况。</p> <p>Q: 请问新能源汽车市场的发展情况如何?</p> <p>A: 新能源汽车市场有望维持增长态势, 加上公司产品已在海外市场出货, 公司对该行业的应用前景保持乐观, 长期而言, 该行业应用的相关产品有望成为公司的第二增长曲线。</p> <p>Q: 请问公司如何看待计算领域的产品应用?</p> <p>A: 计算领域的产品应用从需求上看会有很快速的成长。</p> <p>Q: 请问公司的研发费用和人均研发费用高于同行业平均水平的原因? 海外研发团队的主要研发方向是什么?</p> <p>A: 公司的研发费用和人均研发薪酬较高, 主要是因为公司在海外拥有大量的研发人员, 参考当地的薪酬水平, 其用工成本相对较高, 拉高了公司的人均研发费用。公司海外研发团队主要包括两个研发方向, 一个是对服务器的先进架构和 SOC 电源架构的研究, 另一部分是对汽车芯片产品的开发, 包括车载高/低边开关、高性能的 LDO 和带完整功能安全的 PMIC。</p> <p>Q: 请问公司下游去库存情况如何?</p> <p>A: 消费类应用的库存水平已经基本回归正常, 而在汽车和计算领域, 下游的库存水平相对较高。</p>
--	--

	<p>Q: 请问公司在新领域的产品拓展情况如何? 如卫星通信和 AI 手机方面。</p> <p>A: 首先, 硅阳极锂电池能够让电池容量有所增加, 同步提升待机时长, 有望从高端旗舰机向中端机下沉, 逐步成为手机市场的主流应用。希荻微是整个模拟芯片行业最早推出对应产品的公司, 同时也最早得到客户端认证和量产出货。另外, 随着 AI 需求进一步扩散, 最新一代 CPU 和 AP 的功耗会有所增加, 其对于电源管理芯片的需求会进一步提升, 而卫星通信收发芯片所带来的供电需求也是一个良好的增量市场。希荻微针对上述方向已储备了高性能的芯片产品。</p> <p>Q: 请问公司未来如何规划研发费用占比和盈利时间?</p> <p>A: 公司会有效控制研发团队的规模, 通过优化绩效管理来提高研发团队的产出效率和质量, 公司长期目标是在业绩能够有效成长的前提下, 逐步缩小亏损, 直至实现公司盈利和向股东分红。</p> <p>Q: 请问公司今年在 PC 和服务器领域产品客户进展的情况如何?</p> <p>A: 在服务器和计算通讯领域, 公司产品目前处于送样和客户测试的阶段, 所推广的产品包含了 E-Fuses 保护类芯片产品以及单相和多相的 DC/DC 芯片产品。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动, 公司严格按照相关规定交流沟通, 不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 7 日</p>